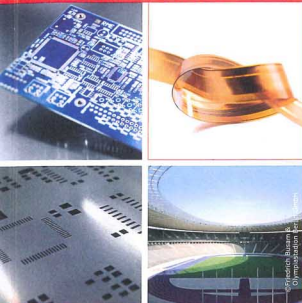


Leitende Ideen – führende Experten

20. und 21. Oktober 2011 in Berlin



©Friedrich Busam & Olympiastadion Berlin

Jetzt anmelden www.conday.de

CONDAY
DAS TECHNOLOGIE-FORUM

ORGAN DER FACHVERBÄNDE

FED



ZVEI



DVS



9

SEPTEMBER 2011
SEITEN 1921-2176
BAND 13

ISSN 1436-7505
B 49475

PRODUKTION VON

LEITERPLATTEN

UND

SYSTEMEN

- + **BAUELEMENTE**
- + **DESIGN**
- + **BESTÜCKUNG**
- + **PACKAGING**
- + **FORSCHUNG & TECHNOLOGIE**

Fachzeitschrift für Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik

Schweizer erweitert Portfolio für die Leistungselektronik um IMS Board

Die Schweizer Electronic AG gab im Juni die Einführung des IMS Boards bekannt. Diese neue und innovative Lösung für Anwendungen in der Leistungselektronik ist in der Lage, hohe Temperaturen über eine Leiterplatte abzuführen. Damit reagiert Schweizer auf die Forderungen des boomenden Leistungselektronikmarktes. Dieser fordert neben immer mehr Stromtragfähigkeit auch eine optimierte Lösung für maximale Entwärmung. Speziell für diesen Zweck wurden Materialien entwickelt, die eine hohe thermische Leitfähigkeit bei gleichzeitig guter elektrischer Isolation bieten. Eine vollflächige, massive Metallrückseite gewährleistet schnelle und effiziente Temperaturspreizung und verhindert somit Hotspots. Marktübliche Insulated Metal Substrate (IMS)-Lösungen sind mit Aluminiumrückseiten ausgestattet. Schweizer empfiehlt im Gegensatz dazu die Nutzung von Kupferrückseiten, welche wesentlich bessere physikalische Eigenschaften bieten. Ein gra-

vierender Unterschied zu Aluminium besteht auch darin, dass Kupfer mit allen Leiterplattenprozessen verträglich ist und somit unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen und mehrlagige Aufbauten ermöglicht. Das Vorhaben richtet sich vor allem speziell an Kunden, die optimierte Hochstrom- und Entwärmungslösungen benötigen. Die IMS-Lösung ergänzt die weiteren optimierten Technologien für die Leistungselektronik:

- Dickkupfer-Boards bis 400 μm – wenn sehr viel Strom über die gesamte Leiterplatte geführt wird
- Combi-Boards – Hochstrom und Signalverarbeitung werden hier kostenoptimiert kombiniert
- Wirelaid – drahtgeschriebene Leiterplatten für kostenoptimierte Hochstromanwendungen
- Inlay Board – für max. Strom und Entwärmung
- Water Board – bei integrierter Wasserkühlung

Weitere Informationen: www.schweizerrelectronic.ag



Entlötssystem MFR-1300



Das Entlöt-/Lötssystem der Serie MFR-1300 ist leistungsstark und erfüllt alle Ansprüche, die Anwender heute an ein Entlötssystem stellen.

- ▶ Eingebaute Membranpumpe
- ▶ Flexibles 2 in 1-Handstück: Pistolen- oder Griffelform
- ▶ Große Lotsammelkammer mit Schnellwechsellvorrichtung
- ▶ Anschlüsse für 2 Lötwerkzeuge
- ▶ Powered by Metcal SmartHeat®-Technologie



productronica
A4.127

Tel.: 06101 5227 470 - E-Mail: d.info@okininternational.com
www.okininternational.com

okininternational

Trainings-Vorteil Anwendungs-Vorteil Produktivitäts-Vorteil